

Shin-Etsu TWSS

薄化ウエハーのプロセスサポート

バックグラインド後のウエハーハンドリングプロセスに応用が可能な
薄ウエハーサポートシステム【Shin-Etsu TWSS】を開発しました。



Features

...

特 長

① Dry processes

Application to Dry process from Wet Process with heat-resistant material and self-adhesive elastomer.

② Cost reduction

Self-adhesive function.
Not necessary the adhesive equipment such as Spin coater equipment and solvent release equipment.

③ Ease of Operation

Self-adhesive elastomer, easy to attach and detach the wafer.

① ドライプロセス

耐熱基材と粘着性エラストマによりドライプロセス化を実現した、半導体プロセス治具です。

② コスト削減

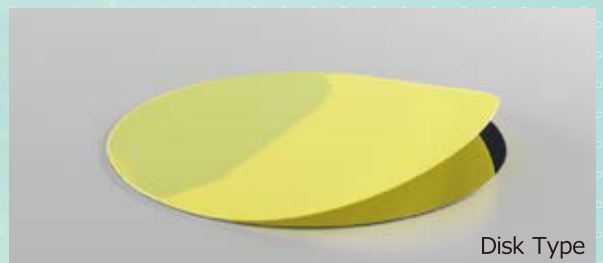
エラストマの自己粘着性を利用しており、接着剤とそれを塗布するためのスピンコータ、また、溶剤剥離プロセス装置などを必要としません。

③ 簡便な使用方法

ウエハーと貼り合わせるだけで、治具を密着させることができます。また、基材をしならせることで、少ない負荷でウエハーから治具をリリースすることが可能です。



Ring Type



Disk Type

④ Application to various processes

Application to various processes for handling of thin wafers. Device cleaning, laser dicing and transportation.

④ 様々なプロセスへの展開

デバイス洗浄や、レーザーダイシング、搬送用途など、薄ウエハーのプロセスハンドリングに、是非ご検討ください。

お問合せ先

信越ポリマー（株）
営業本部 営業第三部 第三グループ
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-9
TEL:03-5289-3739

Shin-Etsu

Shin-Etsu Polymer Co., Ltd.